【19】中華民國　　【12】專利公報　（B）

【11】證書號數：I940716
【45】公告日： 中華民國 115 (2026) 年 10 月 01 日
【51】Int. Cl.：　*A61B5/00　(2006.01)*　*G06Q50/00　(2024.01)*
發明　全 13 頁

【54】名　稱：半導體製造裝置及半導體製造裝置之處理執行方法
【21】申請案號：111143971　【22】申請日： 中華民國 111 (2022) 年 11 月 17 日
【11】公開編號：202335625　【43】公開日期： 中華民國 112 (2023) 年 09 月 16 日
【30】優 先 權： 2021/11/26　日本　2021-191717
【72】發 明 人： 藤井洋路 (JP) FUJII, HIROMICHI；國枝譽 (JP) KUNIEDA, TAKASHI
【71】申 請 人： 日商東京威力科創股份有限公司 TOKYO ELECTRON LIMITED
日本
【74】代 理 人： 何愛文；王仁君
【56】參考文獻：
JP　2004-259030A　　JP　2012-174763A
審查人員：吳丕鈞

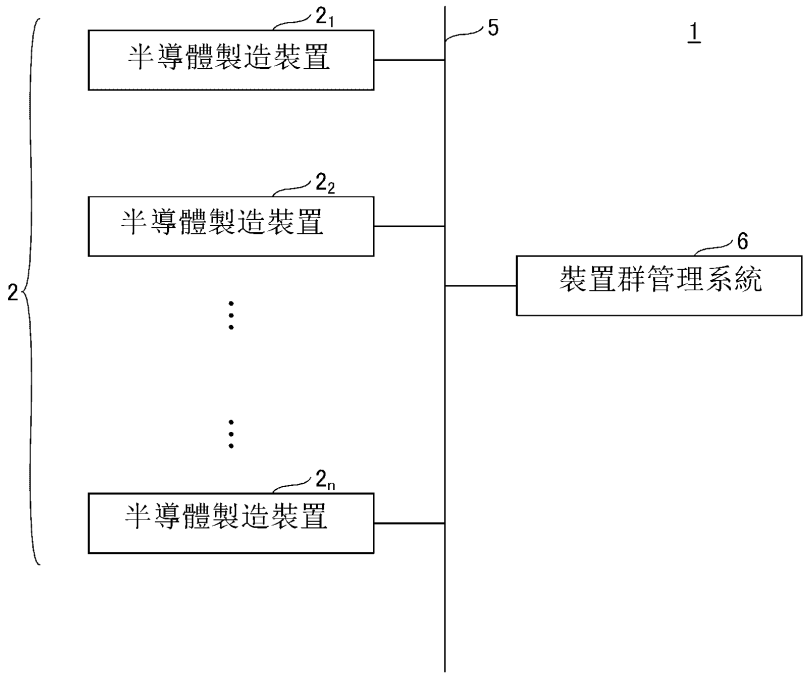
【57】申請專利範圍

1. 一種半導體製造裝置，係具有：
執行指示受理部，係受理針對半導體製造裝置之該半導體製造裝置從能夠進行原本的動作的運轉狀態改變成非為此之狀態之處理的執行指示；
識別資訊受理部，係受理該半導體製造裝置之識別資訊的輸入；以及
執行部，當該半導體製造裝置所預先設定之該半導體製造裝置的識別資訊與該識別資訊受理部所受理之該半導體製造裝置的識別資訊相同且該半導體製造裝置能夠從該運轉狀態改變成非為此之狀態之情況，會對應於該處理的執行指示來執行該處理。
2. 如申請專利範圍第 1 項之半導體製造裝置，其中該處理係該半導體製造裝置的電源關閉、關機或重啟。
3. 一種半導體製造裝置之處理執行方法，係具有以下工序：
受理針對半導體製造裝置之該半導體製造裝置從能夠進行原本的動作的運轉狀態改變成非為此之狀態之處理的執行指示之工序；
受理該半導體製造裝置之識別資訊的輸入之工序；以及
當該半導體製造裝置所預先設定之該半導體製造裝置的識別資訊與所受理之該半導體製造裝置的識別資訊相同且該半導體製造裝置能夠從該運轉狀態改變成非為此之狀態之情況，會對應於該處理的執行指示來對該半導體製造裝置執行該處理之工序。

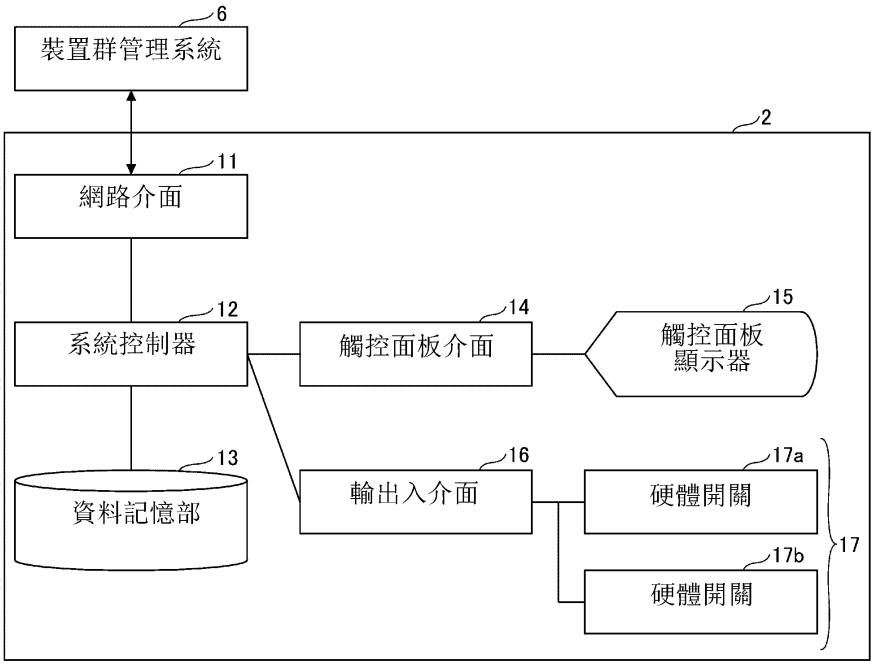
圖式簡單說明

圖 1 為具有半導體製造裝置與裝置群管理系統的處理系統的一例之示意構成圖。
圖 2 為半導體製造裝置的一例之硬體構成圖。
圖 3 為半導體製造裝置所具有的功能之一例的功能構成圖(實施例 1)。
圖 4 為顯示觸控面板顯示器所顯示的畫面的一例的轉變例之圖(實施例 1)。
圖 5 為說明半導體製造裝置進行關機處理之一例的流程圖(實施例 1)。
圖 6 為說明硬體開關的一例的配置例之圖(實施例 2)。
圖 7 為顯示半導體製造裝置所具有的功能之一例的功能構成圖(實施例 2)。
圖 8 為顯示觸控面板顯示器所顯示的畫面的一例的轉變例之圖(實施例 2)。
圖 9 為說明半導體製造裝置進行關機處理之一例的流程圖(實施例 2)。

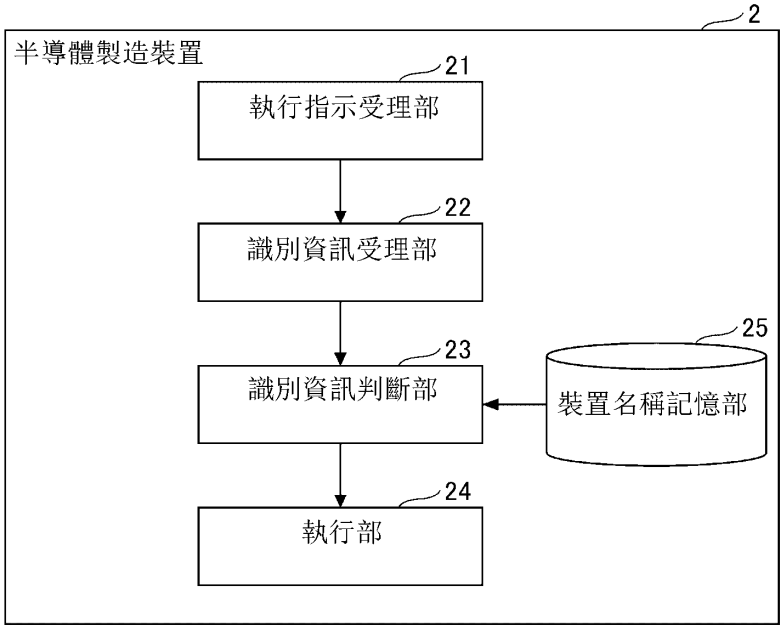
圖 10 為顯示觸控面板顯示器所顯示之畫面的一例的轉變例之圖(實施例 2 之變形例)。
圖 11 為說明半導體製造裝置進行關機處理之一例的流程圖(實施例 2 之變形例)。
圖 12 為顯示半導體製造裝置所具有的功能之一例的功能構成圖(實施例 3)。
圖 13 為顯示預約資訊的一例之圖(實施例 3)。
圖 14 為顯示觸控面板顯示器所顯示之畫面的一例的轉變例之圖(實施例 3)。
圖 15 為說明半導體製造裝置進行關機處理之一例的流程圖(實施例 3)。
圖 16 為顯示預約資訊的一例之圖(實施例 3 之變形例)。
圖 17 為說明半導體製造裝置進行關機處理之一例的流程圖(實施例 3 之變形例)。



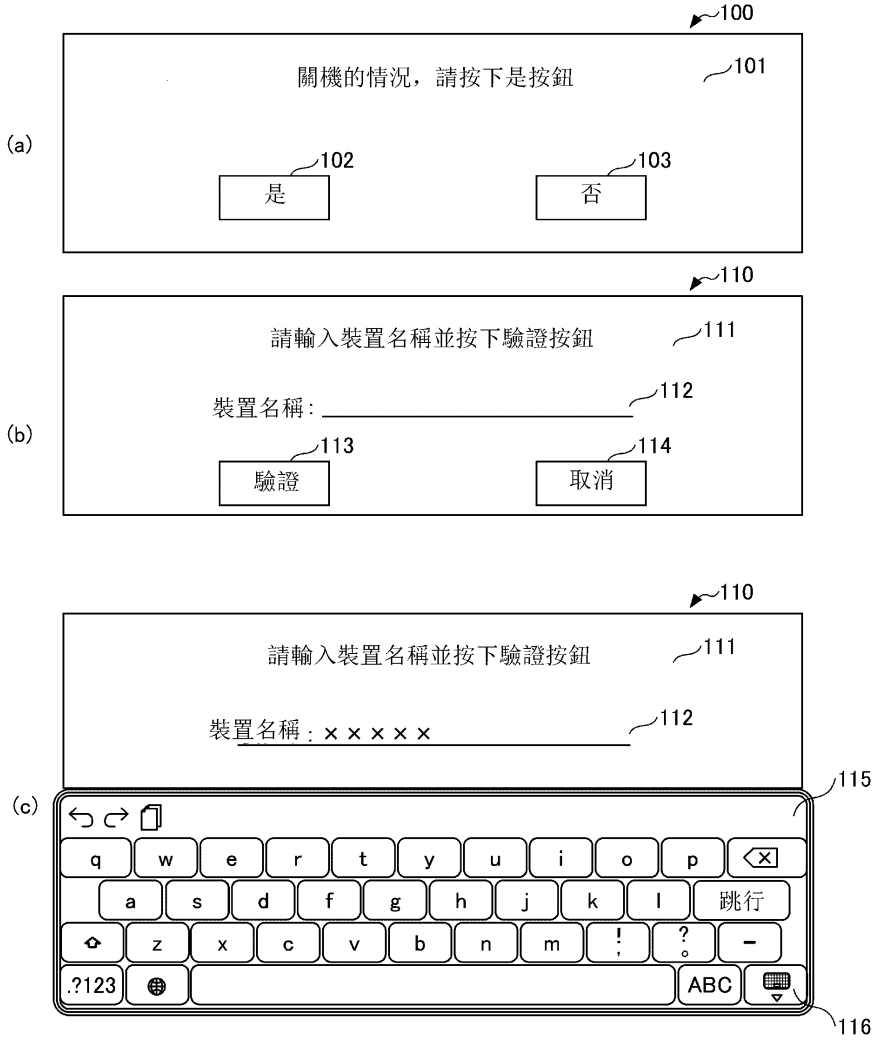
【圖1】


6
裝置群管理系統
2
11
網路介面
12
系統控制器
14
觸控面板介面
15
觸控面板
顯示器
13
資料記憶部
16
輸出入介面
17a
硬體開關
17b
硬體開關
17

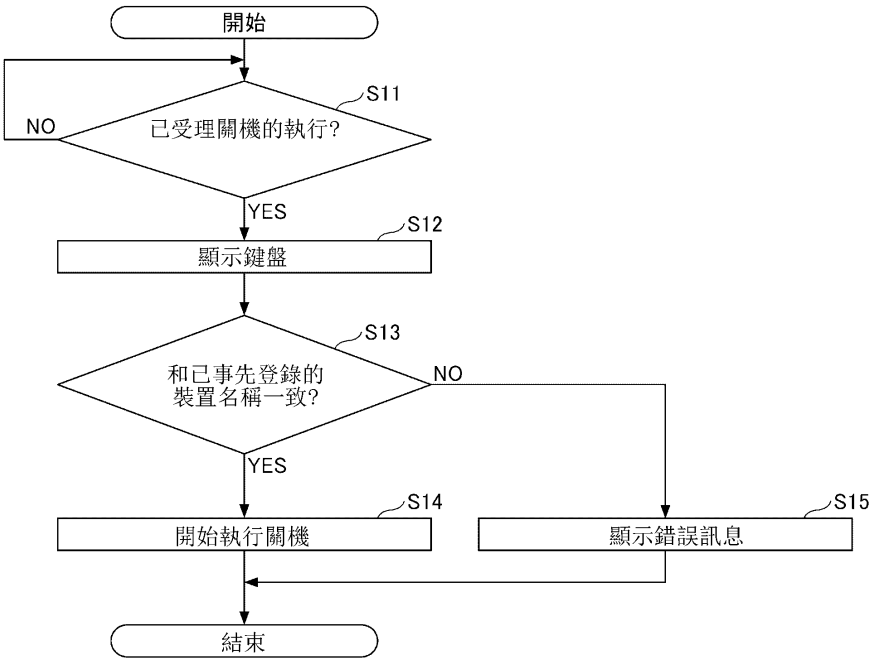
【圖2】


2
半導體製造裝置
21
執行指示受理部
22
識別資訊受理部
25
23
識別資訊判斷部
裝置名稱記憶部
24
執行部

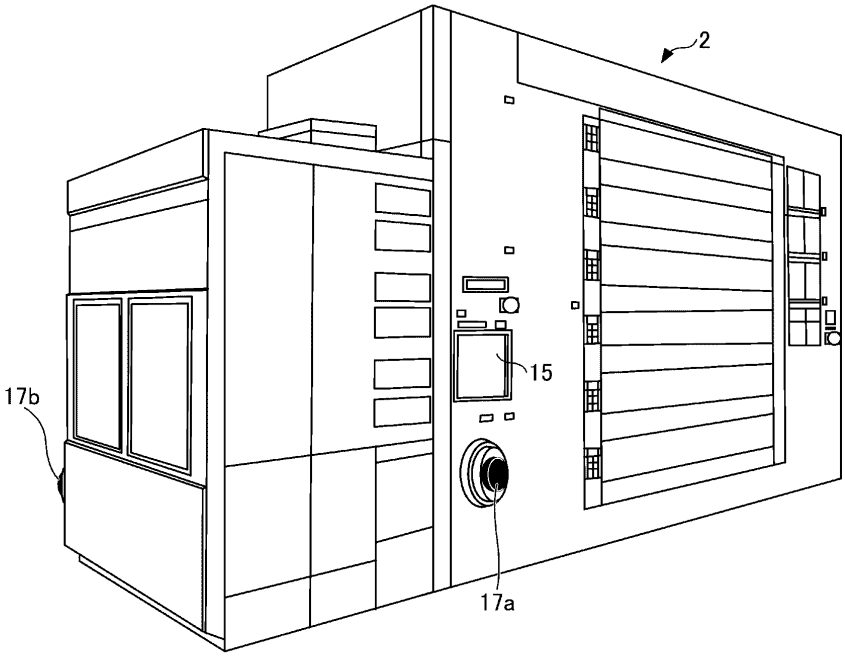
【圖3】


(a)
100
關機的情況，請按下是按鈕
101
102
是
103
否
(b)
110
請輸入裝置名稱並按下驗證按鈕
111
裝置名稱：
112
113
驗證
114
取消
(c)
110
請輸入裝置名稱並按下驗證按鈕
111
裝置名稱：×××××
112
115
跳行
ABC
116

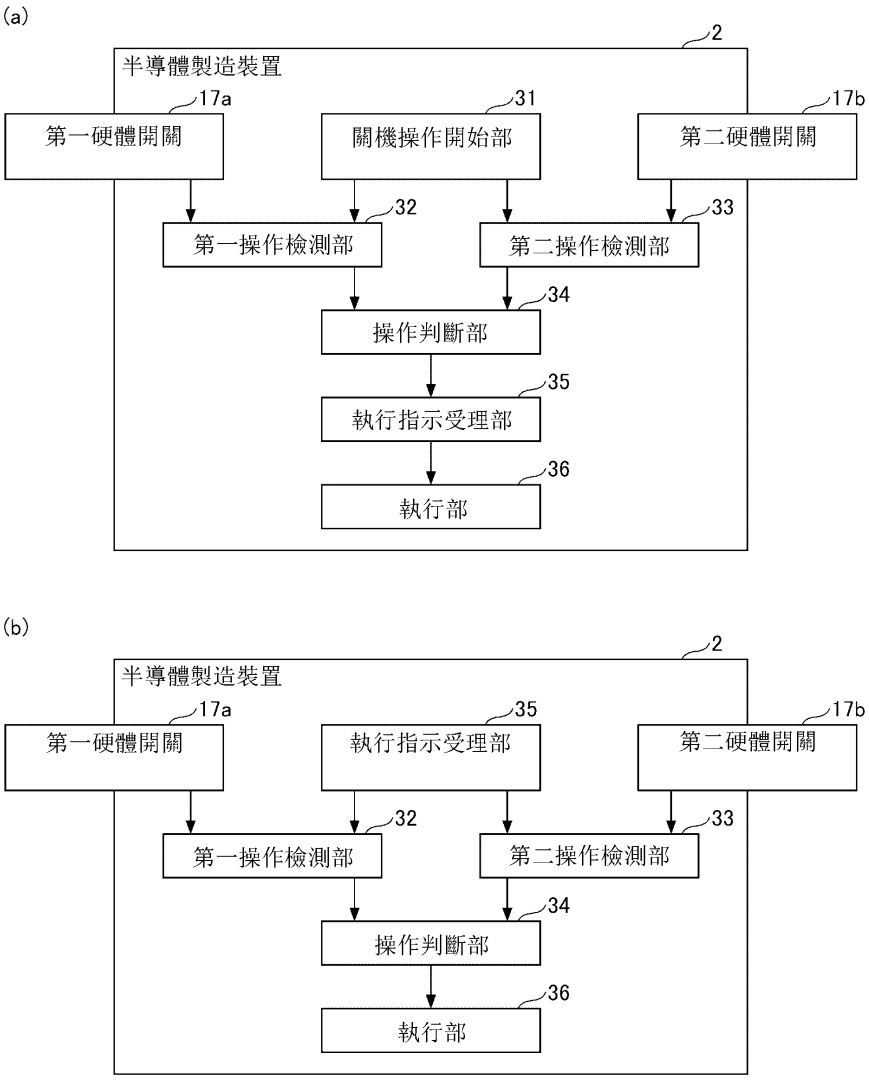
【圖4】


開始
S11
已受理關機的執行?
NO
YES
S12
顯示鍵盤
S13
和已事先登錄的
裝置名稱一致?
NO
YES
S14
開始執行關機
S15
顯示錯誤訊息
結束

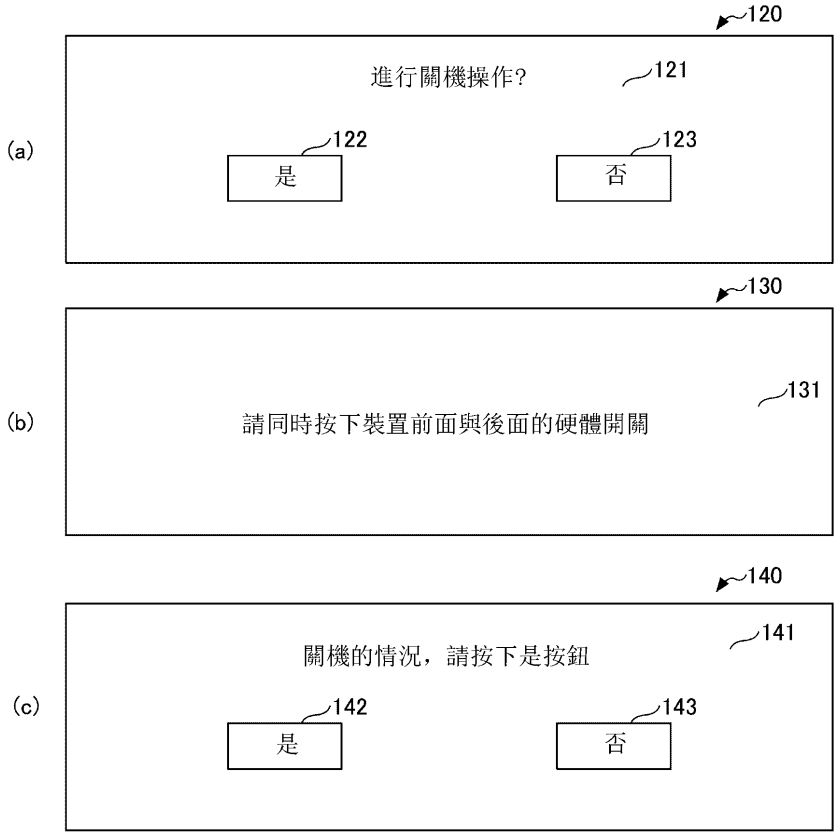
【圖5】



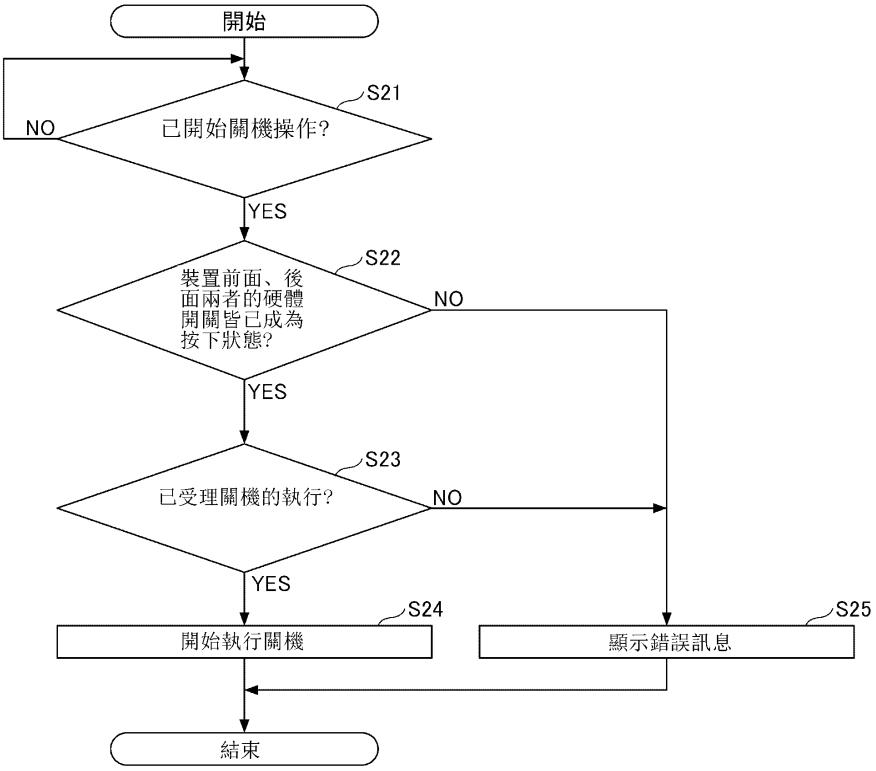
【圖6】


(a)
2
半導體製造裝置
17a
第一硬體開關
31
關機操作開始部
17b
第二硬體開關
32
第一操作檢測部
33
第二操作檢測部
34
操作判斷部
35
執行指示受理部
36
執行部
(b)
2
半導體製造裝置
17a
第一硬體開關
35
執行指示受理部
17b
第二硬體開關
32
第一操作檢測部
33
第二操作檢測部
34
操作判斷部
36
執行部

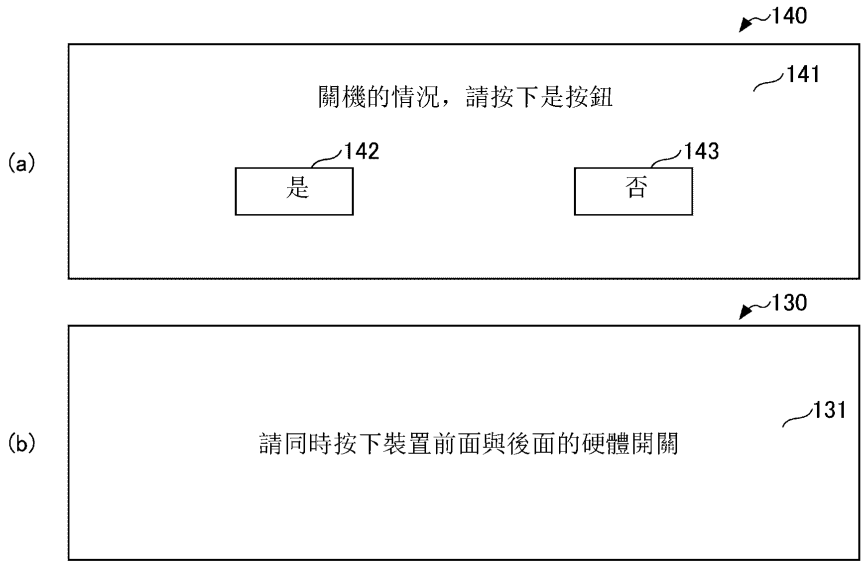
【圖7】


(a)
120
進行關機操作?
121
122
是
123
否
(b)
130
131
請同時按下裝置前面與後面的硬體開關
(c)
140
141
關機的情況，請按下是按鈕
142
是
143
否

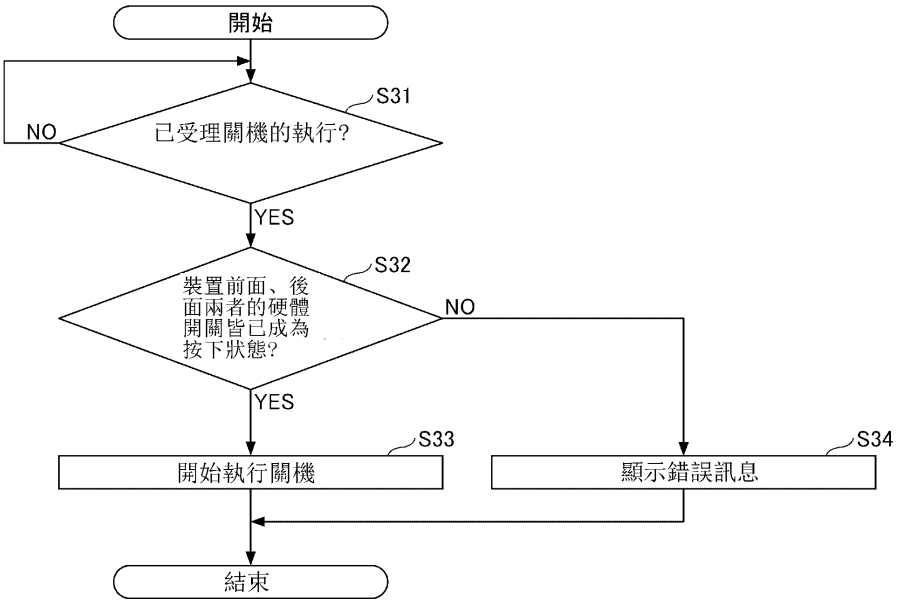
【圖8】


開始
S21
已開始關機操作?
NO
YES
S22
裝置前面、後面兩者的硬體開關皆已成為按下狀態?
NO
YES
S23
已受理關機的執行?
NO
YES
S24
開始執行關機
S25
顯示錯誤訊息
結束

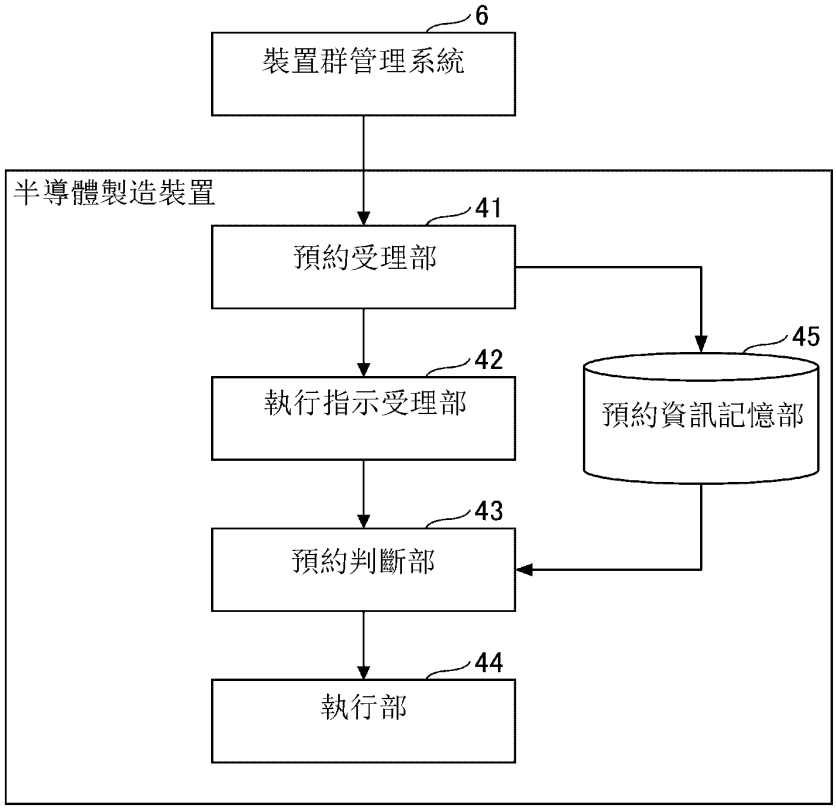
【圖9】


(a)
140
141
關機的情況，請按下是按鈕
142
是
143
否
(b)
130
131
請同時按下裝置前面與後面的硬體開關

【圖10】


開始
S31
已受理關機的執行?
NO
YES
S32
裝置前面、後面兩者的硬體開關皆已成為按下狀態?
NO
YES
S33
開始執行關機
S34
顯示錯誤訊息
結束

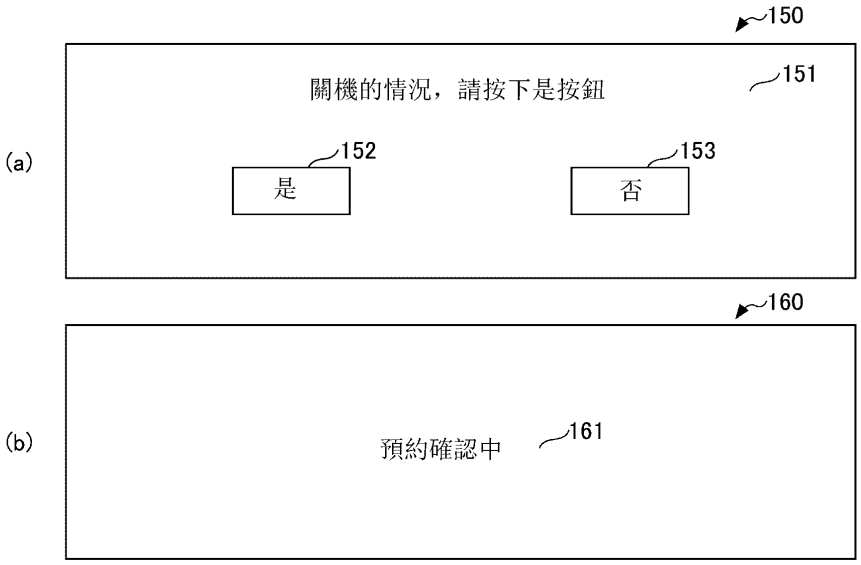
【圖11】


6
裝置群管理系統
半導體製造裝置
41
預約受理部
42
執行指示受理部
45
預約資訊記憶部
43
預約判斷部
44
執行部

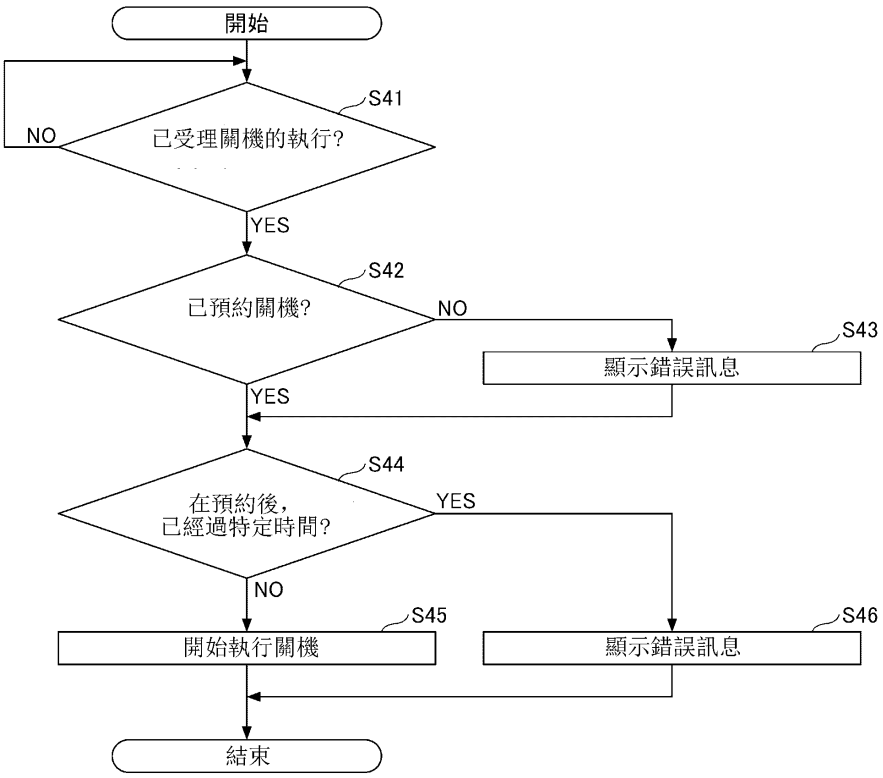
【圖12】

預約受理日時	預約內容
2021/××/××	關機

【圖13】



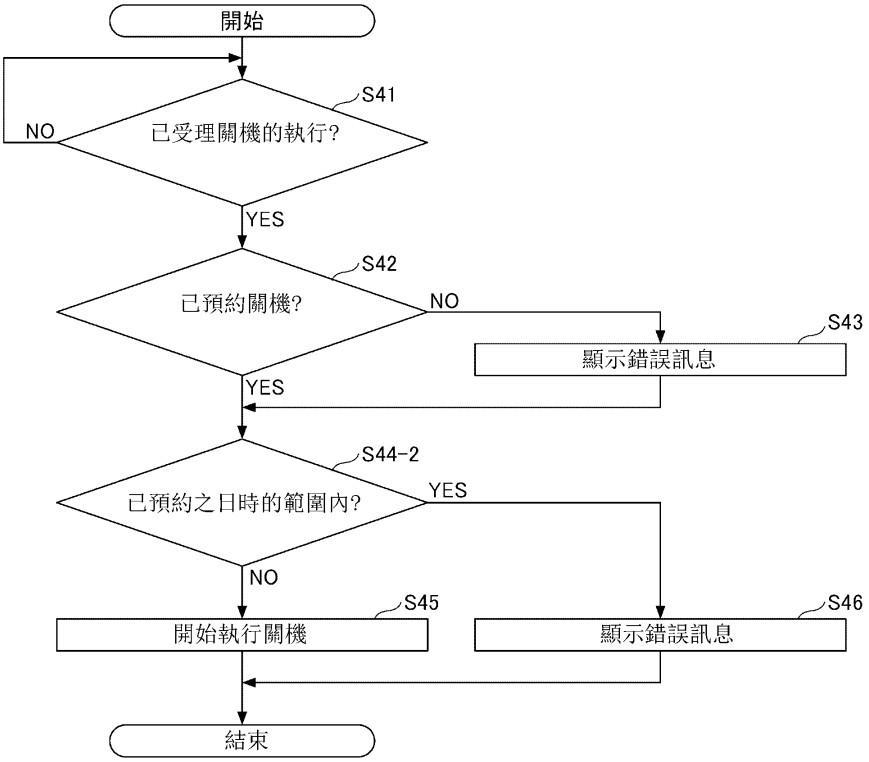
【圖14】



【圖15】

預約受理日時	預約內容	可執行的日時
2021/××/××	關機	2021/××/〇〇 13:00～15:00

【圖16】


開始
S41
已受理關機的執行?
NO
YES
S42
已預約關機?
NO
S43
顯示錯誤訊息
YES
S44-2
已預約之日時的範圍內?
YES
NO
S45
開始執行關機
S46
顯示錯誤訊息
結束

【圖17】